20020044758

24 JUL 2002

162162

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
2. August 2001 (02.08.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/56064 A1

(51) Internationale Patentklassifikation[7]: H01L 21/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/00607

(22) Internationales Anmeldedatum:
19. Januar 2001 (19.01.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
100 03 639.2 28. Januar 2000 (28.01.2000) DE

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: **STEAG RTP SYSTEMS GMBH** [DE/DE]; Daimlerstrasse 10, 89160 Dornstadt (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: **KREISER, Uwe** [DE/DE]; Hasenbühlweg 42, 89081 Ulm (DE). **WEBER, Karsten** [DE/DE]; Gartenstrasse 52-1, 71397 Leutenbach (DE). **LERCH, Wilfried** [DE/DE]; Zwischen den Wiesen 17, 89160 Dornstadt (DE). **GRANDY, Michael** [DE/DE]; Blumenweg 1, 89250 Senden (DE). **SCHMID, Patrick** [DE/DE]; Hardtweg 5, 89160 Dornstadt (DE). **NIESS, Jürgen** [DE/DE]; Höhenweg 13, 89567 Sontheim (DE). **ALTUG, Olgun** [DE/DE]; Kurze Lemppen 11, 89075 Ulm (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: **STEAG RTP SYSTEMS GMBH**; Steag AG, Zentralbereich Recht und Patente, 45117 Essen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten *(national)*: JP, KR, SG, US.

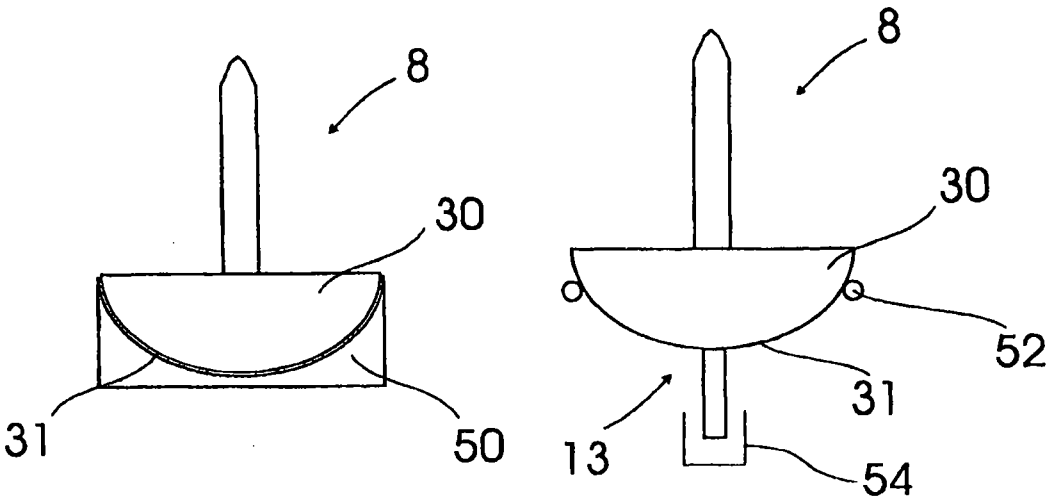
(84) Bestimmungsstaaten *(regional)*: europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

Veröffentlicht:
— *mit internationalem Recherchenbericht*
— *vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen*

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE FOR THERMAL TREATMENT OF SUBSTRATES

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM THERMISCHEN BEHANDELN VON SUBSTRATEN



(57) Abstract: The aim of the invention is to reduce the formation of scratches in a device for the thermal treatment of substrates, in particular, semiconductor substrates, in a chamber in which the substrate is placed upon support elements. According to the invention, said aim is achieved by means of displaceable support elements.

(57) Zusammenfassung: Um bei einer Vorrichtung zum thermischen Bhandeln von Substraten, insbesondere Halbleitersubstraten, in einer Kammer, in der die Substrate auf Stützelementen abgelegt sind, die Bildung von Kratzspuren zu reduzieren, sieht die vorliegende Erfindung bewegliche Stützelemente vor.

WO 01/56064 A1

ACTION

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.